

御中

プロダクト/プロセス変更通知書
Product/Process Bulletin (PB)

件名: TSSOP16パッケージ用リードフレームのダウンセット変更について

《お願い》
誠に勝手ではございますが本通知をもちまして次項に記載しました変更日以降、
該当製品の変更を開始致しますので何卒御理解の程お願い申し上げます。
尚、不明な点がございましたら弊社担当営業へおたずね下さい。



2011年1月7日

フリースケール・セミコンダクター・ジャパン

MSG_Tactical Marketing

該当GPCN番号:

14426

変更内容:

弊社天津工場のTSSOP16パッケージにおいて、リードフレームのダウンセットを従来の7milより5.5milに変更しました。電氣的仕様・信頼性に変更はありません。

変更理由:

モールド封止工程の生産性向上のため。

対象製品:

添付別紙ご参照ください。

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日：2011年1月より

出荷日を特定することは困難です。ご了承ください。

変更品の見分け方:

なし

その他:

PB2011-0002(14426)対象製品

MC68HC908QY1CDTE
MC68HC908QY1VDTE
MC68HC908QY2CDTE
MC68HC908QY2MDTE
MC68HC908QY4CDTE
MC68HC908QY4MDTE
MC68HC908QY4VDTE
MC908QY1CDTER
MC908QY2CDTER
MC908QY4CDTER
MC9RS08KA8CTG
MC9RS08KB12CTG
MC9RS08KB4CTG
MC9RS08KB8CTG
MC9S08QB4CTG
MC9S08QB8CTG
MC9S08QB8CTGR
MC9S08QE4CTG
MC9S08QE4CTGR
MC9S08QE8CTG
MC9S08QE8CTGR
MC9S08QG44CDTE
MC9S08QG44CDTER
MC9S08QG4CDTE
MC9S08QG4CDTER
MC9S08QG4MDTE
MC9S08QG84CDTE
MC9S08QG84CDTER
MC9S08QG8CDTE
MC9S08SE4CTG
MC9S08SE4MTG
MC9S08SE4VTG
MC9S08SE8CTG
MC9S08SE8CTGR
MC9S08SE8MTG
MC9S08SE8VTG
MC9S08SF4MTG
MC9S08SH16CTG
MC9S08SH16CTGR
MC9S08SH16MTG
MC9S08SH32CTG
MC9S08SH32CTGR
MC9S08SH32MTG
MC9S08SH32MTGR
MC9S08SH4CTG
MC9S08SH4CTGR
MC9S08SH4MTG
MC9S08SH4MTGR
MC9S08SH8CTG
MC9S08SH8CTGR
MC9S08SH8MTG
MC9S08SH8MTGR
MCL908QY4CDTE

PB2011-0002(14426)対象製品

MPR083EJ
MPR083EJR2
MPR084EJ
MPR084EJR2
PC667026MTG
PP109955EJ
PP109955EJR2
SC102741QY4MDTE
SC116002MTG
SC667026CTG
SC667026MTG
SC9S08IB4CTG
SC9S08QG8TCDTE
SC9S08QG8TCDTER
SP102972CDTE
SP102972CDTER
SP112819CDTER
SP112821CDTE
SP112821CDTER
SP114857CTG
SP114860CTG
SP114860CTGR
SP115405CTG
SP115405CTGR
SP115406CTG
SP115406CTGR